

日程	項目	内容	資料
1日目 (7時間) 9:00～17:00	安全について レーザ加工概説 マシンの構成について マシンの立ち上げ 画面の構成 始業点検 プログラム登録 加工実習 終業手順	安全上の注意事項(ファイバーレーザー光、ジंकセレン、保護メガネ等) ファイバーレーザーの特長、仕組み、各種切断方法 本体、発振器、NC装置、チラー、コンプレッサー等 作業開始手順(コンプレッサー、NC、発振器、レーザーガス、アシストガス 原点復帰、高圧入) 呼出、編集、加工モニタ、ユーティリティー、加工条件等の概要説明 ユーティリティー画面(保護ガラスの確認、レンズクリーニング、ノズルの確認、 芯出し、センサー調整) プログラムの読み込み、編集(描画モード概要説明) “機械原点スタートのプログラム”と“パーツ基準スタートするプログラム”について サンプルプログラム加工(SPCC 1. 2mm) 配置基準点の変更して加工実習 終業手順(発振器停止、NC電源OFF、各種ガス、コンプレッサー等)	レーザ加工概説 ENSIS-AJeテキスト
2日目 (7時間) 9:00～17:00	加工実習 編集画面(描画モード)の 機能説明および加工実習 各種切断方法 端材切断	1日目の復習(立ち上げ～加工前の段取り、プログラム読込～加工) 工具径補正の調整方法 材料情報、基準位置変更、多数個取り、切断条件変更、終値設定、端材切断 板取 酸素カット、窒素カット、エコカット 軟鋼切断、ステンレス切断、表面処理鋼板切断、アルミ切断 ユーティリティーの端材切断	ENSIS-AJeテキスト レーザ切断加工補足資料 AJ各種切断方法 レーザ切断加工補足資料

※カリキュラムの内容は、変更になることがあります。